

2021.09.21 新产品发布

针对半导体封装线路微细化之对应 $\Phi 30\mu\text{m}$ 直径的植球系统设备开始销售的通知

艾美柯技术株式会社 (AIMECHATEC, Ltd., 总部: 日本茨城县龙崎市向阳台, 社长: 阿部猪佐雄) 现发布, 作为半导体相关事业的新提案, 开始销售新产品“对应 $\Phi 30\mu\text{m}$ 直径的植球系统设备”。

本系统设备是为了应对半导体封装线路微细化, 在本公司核心技术之一的喷墨技术的基础上研制开发而成。其中助焊剂的印刷工艺, 是以喷墨技术来代替传统的模板工艺, 从而实现了均匀涂布, 更适合于窄间距化的生产。将助焊剂喷涂设备与现有的高精度焊锡植球设备以及高速检查修补设备结合起来, 作为一套综合解决方案实现了 $\Phi 30$ 微米直径焊锡球的贴装工艺。(已取得专利)

本公司的喷墨技术, 已被众多平板显示为主的客户所采用。为了应对半导体封装贴装制程工艺的更加微细化, 我们会在现有的喷墨技术的基础上, 不断研制开发新的工程工艺。

现在5G通讯、大数据(Big Data)、物联网(IoT)、人工智能(AI)等的普及在逐渐加速, 所利用的数据中心、移动终端以及车载终端等的半导体封装的需求量也在扩大, 同时也需要应对高速·高功能和小直径焊锡球的需求。其中先进半导体封装, 其需求更为显著, 所以本系统设备将成为最佳选择。

敝公司愿意通过制程工艺上的不断创新, 为了创造更舒适方便, 更丰富多彩的生活方式, 为社会做出更多的贡献而努力。

咨询: 艾美柯技术株式会社
营业部 TEL: 0297-62-9119

https://www.ai-mech.com/wp_zh/newproducts/



对应 $\Phi 30\mu\text{m}$ 直径植球系统 (外观)